

平成14年3月期 決算短信 (連結)



平成14年5月23日

会社名 **テクノーク株式会社**

登録銘柄

コード番号 5217

本社所在都道府県 山形県

(URL: <http://www.techno-q.com>)

本社所在地 山形県山形市蔵王松ヶ丘二丁目1番地4

問合せ先 責任者役職名 常務取締役 経理部長

氏名 大室 赳

TEL 023(695)3300

決算取締役会開催日 平成14年5月23日

親会社名 ジーエルサイエンス株式会社(コード番号: 7705)

親会社における当社の株式保有比率 65.1%

米国会計基準採用の有無 無

1. 14年3月期の連結業績 (平成13年4月1日~平成14年3月31日)

(1) 連結経営成績 (百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年3月期	4,040	(-)	376	(-)	354	(-)
13年3月期		(-)		(-)		(-)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%
14年3月期	120	(-)	15	45	-	-	1.8	3.8
13年3月期		(-)	-	-	-	-		8.7

- (注)1. 持分法投資損益 14年3月期 - 百万円 13年3月期 - 百万円
 2. 期中平均株式数(連結) 14年3月期 7,799,600株 13年3月期 株
 3. 会計処理の方法の変更 無
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益における \uparrow - \searrow 表示は、対前期増減率

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
14年3月期	9,271	6,631	71.5	850	18
13年3月期					

(注) 期末発行済株式数(連結) 14年3月期 7,799,600株 13年3月期 株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
14年3月期	432	1,225	794	652
13年3月期				

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 - 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社

2. 15年3月期の業績予想 (平成14年4月1日~平成15年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	1,870	90	43
通期	4,075	305	140

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 17円95銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項については、添付資料の5ページをご参照ください。

1. 企業集団の状況

当社の企業集団は、当社と親会社、および、当社の子会社2社で構成されております。

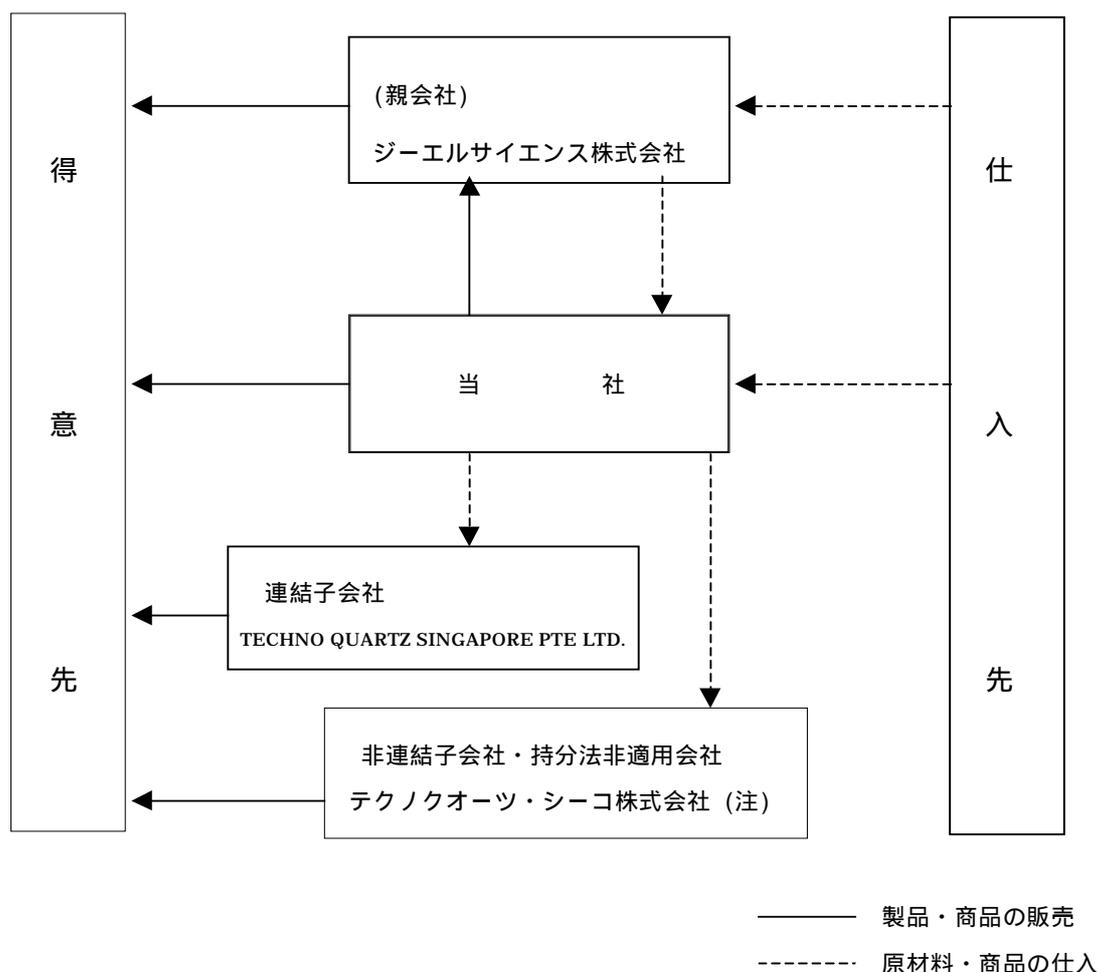
当社は半導体用石英製品等の製造・仕入・販売を主な事業内容としており、親会社であるジーエルサイエンス株式会社へ製品の一部を供給しております。

当社の親会社であるジーエルサイエンス株式会社は、クロマトグラフの装置・消耗品、ガス精製装置等の製造・販売を主な事業内容としております。

当社の子会社TECHNO QUARTZ SINGAPORE PTE LTD. は、当社が100%出資した現地法人であり、当社製品の販売を主な事業内容としております。

親会社の子会社であった株式会社エイアイテクノロジーは、平成13年10月1日をもって親会社ジーエルサイエンス株式会社に営業の全部を譲渡し、解散しております。

なお、事業部門別の事業の内容につきましては、半導体製造関連が大半を占めておりますので、記載を省略しております。事業の系統図は次のとおりであります。



(注)非連結子会社テクノクオーツ・シーコ株式会社に対する持分割合は50%であります。実質的に支配しているため、子会社としております。

2. 経営方針

(1) 経営の基本方針

当社は、ジーエルサイエンス株式会社（店頭 7 7 0 5）の連結対象子会社として創立以来経営の基本理念を共有しております。

それは、「社会に対し社会性を充分発揮してその存在価値を高め、社員個々の幸福を勝ち取り、企業の維持、発展をならしめること」を基本理念とする活動を続け、そこから得られた利益を株主、社員、社会に公正に分配し、そして会社の事業内容を充実、発展させることが最大の社会性を意味することと考えております。

(2) 利益配当に関する基本方針

当社は、株主の皆様に対する安定的利益還元を重要課題として認識しております。自己資本の充実と長期にわたる収益力向上のため、経営基盤の充実を図るとともに、積極的に株主の皆様への利益還元に取り組む方針であります。

このような方針に基づき、当期の株主配当金につきましては、普通配当を 1 株につき 1 5 円の配当を予定しております。

(3) 会社が対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、景気は米国経済の影響を受け一部下げ止まりからやや回復の兆しは見えるものの、設備投資の大幅な減少や依然として厳しい雇用・所得環境から民間需要を下押しする懸念があり、予断を許さない状況が当面続くものと思われま

す。半導体関連産業は、かつてない世界的な IT 不況に見舞われましたが、在庫調整が一巡し最悪期を脱し回復の基調にあります。しかし半導体市況は非常に不透明であり、急速な好転は期待できない環境にあり、今後とも厳しい経営環境が続くものと予想されます。このような環境のなかで、当社は引き続き情報収集力の向上に努め、より顧客ニーズをとらえた営業戦略を展開するとともに、市場環境の変化に対応しうるコスト低減に注力し、価格競争力を保持した企業体質の強化を図り、業績の向上に全力を傾注する所存であります。

販売面につきましては国内のみならず、平成 12 年に設立致しました当社 100% 出資子会社である TECHNO QUARTZ SINGAPORE PTE LTD を通じて顧客要求にオンデマンド対応のサービス体制をより強化し、顧客満足を追

求致します。また、当社は半導体生産、製造用装置の最大生産国である米国市場に対する浸透に注力し、来期は、市場開拓を目的として米国・カリフォルニア州、サンタクララ市に駐在員事務所の開設を予定しております。これまでの営業活動の結果として既に複数の得意先より当社製品の採用を検討されております。この事は米国においても当社製品の品質技術等に対する高い信頼と、現地サポート体制に対する顧客からの高い評価の現れと考えております。

当社は、この様な営業活動を背景に半導体関連ビジネス市場のグローバル化並びに汎用品の低価格化等の多様な要求に対応するために、中国・杭州市に生産拠点を設置する準備を進めており、来期中には生産活動を開始したいと考えております。当社はこれらの施策を実現する事により今後の更なる成長が可能であると確信しております。

3. 経営成績

(1) 当期連結会計年度の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国経済の減速による輸出の落ち込み、生産の大幅減少の影響が雇用・所得面にも広がりをもたらし、一段と厳しさを増す展開で推移いたしました。

半導体業界は、平成11年下期から回復に転じた需要増大傾向も、平成13年はじめより需要の減速感が強まり、第二四半期以降は急激なブレーキがかかる状況となりました。これは米国発のITバブルの崩壊が、世界経済のグローバル化の影響によって全世界に波及した結果、かつてない『IT不況』を引き起こしたものであり、半導体需要の約40%を占めるパソコン市場は出荷台数で86年以降初めてマイナスを記録するなど大幅な需要減退となりました。

また、半導体デバイスの価格は大幅に下落し、DRAM（記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリー）にいたっては、128メガビットの価格が前年度の価格の10分の1以下にまで値下がりするなど、国内、海外ともに半導体製造各社は大幅な減産、生産能力の統廃合を行なわざるを得ない状況となりました。

半導体関連需要の極端な減速の影響は新規設備投資の抑制、凍結姿勢を強め、その結果、半導体メーカーのみならず、半導体製造装置メーカー各社も過去に経験のない受注減少に直面することになり、当社においてもその影響を受けざるを得ない環境となりました。

さらに9月に米国で発生した同時多発テロは世界規模で個人消費を冷え込ませる引き金となり、そのような市場環境を受けて半導体製造関連各社は軒並み過去に経験の無い大幅な赤字を計上、海外生産子会社の整理、DRAM生産からの撤退等、半導体生産事業の再構築を迫られる状況となりました。

このような環境のもと、当社は、新規既存の得意先に対する密着した営業の進展を図り、シェアの拡大に努めるとともに他社との競合に備えたコスト低減に注力し、高付加価値製品の開発製造への転換を企図いたしました。

その具体的対応として、現有のシリコン製品群の関連特許を所有するドイツ・シーコ社との合併でテクノクオーツ・シーコ株式会社を設立、次世代プロセスに不可欠なシリコンウエーハ処理を可能ならしめる一体型シリコンボート製造のため、本社・蔵王工場が立地する山形市蔵王産業団地内に、敷地面積6,000坪（19,834.72㎡）、延床面積2,300坪（7,656.52㎡）の蔵王南工場を建設致しました。

また、一方で弊社工場の生産能力および適性をもとに、生産製品および生産体制の再構築を検討いたしました。その結果、老朽化が進み、かつ拡張余地の乏しい埼玉工場を閉鎖・統合致しました。当社は今後においても生産性向上、新規商品の開発生産のための積極的投資を行い、有効なスクラップ・アンド・ビルドを推進して行く方針であります。

これらの結果、売上高は40億4千万円、営業利益は3億7千6百万円、経常利益は3億5千4百万円、当期利益は1億2千万円となりました。

なお、当連結会計期間において新規に連結財務諸表を作成しているため前年同期との比較分析は行っておりません。

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純利益が2億2千9百万円であったものの、売上債権の回収及び投資有価証券の売却等により、当事業年度末では6億5千2百万円となりました。

(営業活動による連結キャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、4億3千2百万円となりました。

これは、税金等調整前当期純利益が2億2千9百万円と前事業年度末に比べ減少したものの、売上債権の減少（回収増）が大きく寄与し、第4四半期の生産、販売の増加に起因する棚卸資産の増加、在庫調整のための仕入債務減少等のマイナス要因があったものの、上記結果となっております。

(投資活動による連結キャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、12億2千5百万円となりました。

これは、蔵王産業団地内に建設した蔵王南工場の建設費および設備の取得に14億1百万円の投資を行い、投資有価証券3億円の売却による収入があったものの、上記結果となっております。

(財務活動による連結キャッシュ・フロー)

当連結会計年度において財務活動による資金の増加は、7億9千4百万円となりました。

これは、設備資金としての長期借入金12億円の資金調達が起因し、借入金の返済、配当金の支払等があったものの、上記結果となっております。

なお、当連結会計年度より「連結キャッシュ・フロー計算書」を作成しているため、「営業活動」、「投資活動」、及び「財務活動」による各連結キャッシュ・フローについては、前年同期との比較分析は行っておりません。

(3) 次期の見通し

来期の当社を取り巻く環境は、当期は半導体関連産業がかってない世界的なIT不況に見舞われましたが、在庫調整が一巡し回復の基調にあります。しかし、半導体市況は非常に不透明であり、急速な好転は期待できない環境であり、厳しい経営環境が続くものと予想されます。

この環境下で当社は、当期に設立したテクノクォーツ・シーコ社が製造する一体型シリコンポートの拡販、米国市場の開拓を目的とした駐在員事務所の開設および半導体関連ビジネス市場のグローバル化と汎用品の低価格化等の多様な要求に対応する生産拠点を中国、杭州市に設置する等の対応を行い、業績の向上に努めていく所存でございます。

当社の平成15年3月期連結業績予想は、売上高40億7千5百万円、経常利益3億5百万円、当期純利益1億4千万円を見込んでおります。

4.連結財務諸表等

(1)連結貸借対照表

(千円未満切捨表示)

科 目	期 別	当連結会計年度 (平成14年3月31日現在)	
		金 額	構成比
(資産の部)		千円	%
流動資産			
1.現金及び預金		1,219,039	
2.受取手形及び売掛金		1,191,744	
3.有価証券		60,036	
4.たな卸資産		1,939,425	
5.繰延税金資産		32,244	
6.その他		367,212	
貸倒引当金		2,800	
流動資産合計		4,806,902	51.8
固定資産			
1.有形固定資産			
(1)建物及び構築物	2,603,361		
減価償却累計額	682,280	1,921,081	
(2)機械装置及び運搬具	1,867,384		
減価償却累計額	1,111,979	755,405	
(3)土地		1,068,870	
(4)建設仮勘定		9,623	
(5)その他	242,780		
減価償却累計額	138,297	104,482	
有形固定資産合計		3,859,462	41.6
2.無形固定資産		72,440	0.8
3.投資その他の資産			
(1)投資有価証券		173,829	
(2)長期貸付金		90,000	
(3)その他		260,010	
(4)繰延税金資産		97,161	
貸倒引当金		88,000	
投資その他の資産合計		533,001	5.8
固定資産合計		4,464,904	48.2
資産合計		9,271,807	100.0

(千円未満切捨表示)

期 別 科 目	当連結会計年度 (平成14年3月31日現在)	
	金 額	構成比
(負債の部)	千円	%
流動負債		
1.支払手形及び買掛金	249,774	
2.短期借入金	559,412	
3.賞与引当金	102,888	
4.その他	194,715	
流動負債合計	1,106,787	11.9
固定負債		
1.長期借入金	1,201,832	
2.退職給付引当金	68,657	
3.役員退職金引当金	64,430	
4.繰延ヘッジ利益	198,640	
固定負債合計	1,533,559	16.6
負債合計	2,640,347	28.5
(少数株主持分)		
少数株主持分		
(資本の部)		
資本金	829,350	8.9
資本準備金	1,015,260	10.9
連結剰余金	4,798,786	51.8
その他有価証券評価差額金	397	0.0
為替換算調整勘定	10,528	0.1
小計	6,632,471	71.5
自己株式	1,011	0.0
資本合計	6,631,460	71.5
負債・少数株主持分 及び資本合計	9,271,807	100.0

(2) 連結損益計算書

(千円未満切捨表示)

期 別 科 目	当連結会計年度 〔平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで〕	
	金 額	百分率
売上高	千円 4,040,966	100.0
売上原価	2,791,996	69.1
売上総利益	1,248,969	30.9
販売費及び一般管理費		
1.販売促進費	96,333	
2.役員報酬	101,847	
3.給料手当	192,078	
4.賞与引当金繰入額	24,047	
5.退職給付費用	15,265	
6.役員退職金引当金繰入額	11,211	
7.その他	431,815	872,599
営業利益	376,369	21.6
営業外収益		9.3
1.受取利息	3,251	
2.受取配当金	10,908	
3.その他	14,048	28,208
営業外費用		0.6
1.支払利息	21,101	
2.為替差損	20,346	
3.その他	8,294	49,742
経常利益	354,836	1.2
特別利益		8.7
1.貸倒引当金戻入益	7,535	
2.補助金収入	83,406	90,941
特別損失		2.3
1.固定資産売却損	1,176	
2.固定資産除却損	2,718	
3.貸倒引当金繰入額	42,500	
4.投資有価証券評価損	20,160	
5.固定資産圧縮損	83,406	
6.工場閉鎖損失	59,018	
7.会員権評価損	7,710	216,689
税金等調整前当期純利益	229,088	5.4
法人税、住民税及び事業税	90,000	5.6
法人税等調整額	18,531	108,531
当期純利益	120,557	2.7
		2.9

(3) 連結剰余金計算書

(千円未満切捨表示)

科 目	当 連 結 会 計 年 度 〔平成13年 4月 1日から〕 平成14年 3月31日まで	
	千円	千円
連結剰余金期首残高		4,951,656
連結剰余金減少高		
1.配 当 金	249,587	
2.役 員 賞 与 金	23,840	273,427
当 期 純 利 益		120,557
連結剰余金期末残高		4,798,786

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(千円未満切捨表示)

科 目	期 別	当連結会計年度 〔平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで〕
		金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		千円
1.税金等調整前当期純利益		229,088
2.減価償却費		373,245
3.貸倒引当金の増加額(減少額)		34,964
4.賞与引当金の増加額(減少額)		17,444
5.退職給付引当金の増加額(減少額)		27,663
6.役員退職金引当金の増加額(減少額)		11,211
7.受取利息及び受取配当金		14,159
8.支払利息		21,101
9.為替差損		6
10.有形固定資産売却損		15,394
11.固定資産除却損		3,894
12.有形固定資産圧縮損		83,406
13.投資有価証券評価損		20,160
14.会員権評価損		7,710
15.売上債権の減少額(増加額)		1,399,974
16.たな卸資産の減少額(増加額)		190,354
17.仕入債務の増加額(減少額)		562,752
18.未収還付消費税等の減少額(増加額)		99,522
19.未払消費税等の増加額(減少額)		28,332
20.役員賞与の支払額		23,840
21.その他		102,441
小 計		1,188,972
22.利息及び配当金の受取額		14,177
23.利息の支払額		21,669
24.法人税等の支払額		749,206
営業活動によるキャッシュ・フロー		432,273
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1.定期預金の預入による支出		697,123
2.定期預金の払戻による収入		652,661
3.有形固定資産の取得による支出		1,401,465
4.無形固定資産の取得による支出		61,553
5.投資有価証券の取得による支出		639
6.投資有価証券の売却による収入		300,000
7.子会社株式の取得による支出		5,000
8.貸付による支出		5,000
9.その他		7,476
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,225,597

(千円未満切捨表示)

科 目	期 別	当連結会計年度 〔平成13年4月1日から〕 〔平成14年3月31日まで〕
		金 額
財務活動によるキャッシュ・フロー		千円
1.短期借入金の増加額(減少額)		38,220
2.長期借入による収入		1,200,000
3.長期借入金の返済による支出		194,992
4.配当金の支払額		248,568
財務活動によるキャッシュ・フロー		794,659
現金及び現金同等物に係る換算差額		10,535
現金及び現金同等物の増加額		9,200
現金及び現金同等物の期首残高		641,439
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		20,628
現金及び現金同等物の期末残高		652,867

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

子会社は、TECHNO QUARTZ SINGAPORE PTE LTD.とテクノクーツ・シーコ株式会社の2社であります。

TECHNO QUARTZ SINGAPORE PTE LTD.は重要性が増加したため、当連結会計期間より連結の範囲に含めております。

テクノクーツ・シーコ株式会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び剰余金(持分に見合う額)は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲より除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項

テクノクーツ・シーコ株式会社は、連結純損益及び連結剰余金に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

3. 連結子会社の決算日等に関する事項

連結子会社であるTECHNO QUARTZ SINGAPORE PTE LTD.の決算日は、12月31日であります。連結財務諸表を作成するに当たっては決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日までの期間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

時価のないもの

総平均法による原価法

たな卸資産

製品及び仕掛品……個別法に基づく原価法

なお、仕掛原材料については移動平均法に基づく原価法によっております。

原材料及び貯蔵品……移動平均法に基づく原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

当社は定率法を、また、在外連結子会社は当該国の会計基準の規定に基づく定額法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。

建物及び構築物	10～40年
機械装置及び運搬具	2～15年

無形固定資産

定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3)重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため一般債権については、貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来支給見込額のうち当連結会計年度末の費用負担額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計期間末において発生していると認められる額を費用計上しております。

役員退職金引当金

連結財務諸表提出会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職金規程に基づく連結会計期間末要支給額を計上しております。

(4)重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5)重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

(6)重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を採用しております。

ヘッジ手段として為替予約を実施しており、ヘッジ対象は外貨建予定取引等であります。

(7)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

5. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資を計上しております。

注 記 事 項

(連結貸借対照表関係)

当 連 結 会 計 年 度	
(平成14年3月31日現在)	
1. 資産につき設定している担保権の明細	
担保資産	
建物及び構築物	1,838,230千円
土 地	990,078千円
計	2,828,308千円
担保資産に対応する債務	
短期借入金	261,992千円
長期借入金	790,032千円
計	1,052,024千円
2. 過年度に取得した土地のうち国庫補助金等による 圧縮記帳額は300,000千円であり、連結貸借対照表 計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。	
3. 連結会計期間末日満期手形の処理	
手形交換日をもって決済処理しております。	
当連結会計期間末日は金融機関の休業日であった ため、受取手形 23,270 千円の連結会計期間末日満 期手形が連結会計期間末残高に含まれております。	

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当 連 結 会 計 年 度	
〔平成13年4月1日から〕	
〔平成14年3月31日まで〕	
1. 現金及び現金同等物の連結会計期間末残高と連結貸借 対照表に掲記されている科目の金額との関係	
現金及び預金勘定	1,219,039千円
有価証券勘定	60,036千円
計	1,279,075千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	576,208千円
MMFを除く有価証券	50,000千円
現金及び現金同等物	652,867千円

(リース取引関係)

該当事項はありません。

5. セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める半導体事業の売上高、営業利益の割合が、いずれも90%を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 所在地別セグメント情報

当連結会計年度（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の売上高の割合が、いずれも90%を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

3. 海外売上高

当連結会計年度（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）

	アジア地域	その他の地域	計
	千円	千円	千円
海外売上高	553,302	132,042	685,345
連結売上高			4,040,966
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	13.7	3.3	16.9

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア地域・・・シンガポール、台湾、韓国

(2) その他の地域・・・ドイツ、イギリス、アメリカ

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績を事業のセグメントごとに示すと次のとおりであります。

(単位：千円)

事業の種類別セグメントの名称	生産高
半導体製造装置用製品	3,683,162
理化学機器用製品	94,351
電化製品その他	19,117
合計	3,796,631

(注) 1.金額は販売価格によっております。

2.金額は消費税等を含んでおりません。

(2) 受注実績

当連結会計年度における受注実績を事業のセグメントごとに示すと次のとおりであります。

(単位：千円)

事業の種類別セグメントの名称	受注高	受注残高
半導体製造装置用製品	3,098,502	543,844
理化学機器用製品	91,085	2,440
電化製品その他	44,702	7,933
合計	3,234,291	554,218

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業のセグメントごとに示すと次のとおりであります。

(単位：千円)

事業の種類別セグメントの名称	販売高
半導体製造装置用製品	3,897,327
理化学機器用製品	94,351
電化製品その他	49,287
合計	4,040,966

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。

7. 有価証券

当連結会計年度（平成14年3月31日現在）

1. その他有価証券で時価のあるもの

区 分	取得原価	連結会計期間末日における連結貸借対照表計上額	差 額
連結貸借対照表計上額が取得価額を超えるもの	千円	千円	千円
株 式	28,727	49,829	21,101
そ の 他			
小 計	28,727	49,829	21,101
連結貸借対照表計上額が取得価額を超えないもの			
株 式	87,284	83,110	4,174
そ の 他	51,000	33,390	17,610
小 計	138,284	116,500	21,784
合 計	167,011	166,329	682

2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売 却 額	売却益の合計額	売却損の合計額
千円	千円	千円
300,000		

3. 時価評価されていない有価証券

(1) 子会社株式及び関連会社株式

内 容	連結貸借対照表計上額
	千円
子 会 社 株 式	5,000
合 計	5,000

(2) その他有価証券

内 容	連結貸借対照表計上額
	千円
劣 後 債	50,000
マネー・マネージメント・ファンド	10,036
店頭売買株式を除く非上場株式	2,500
合 計	62,536

4. その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額

内 容	1 年 以 内	1 年 超 5 年 以 内	5 年 超 10 年 以 内	1 0 年 超
	千円	千円	千円	千円
そ の 他	50,000			
合 計	50,000			

8. デリバティブ取引

当社が行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため、記載の対象から除いております。

9. 退職給付関係

当連結会計年度 (平成14年3月31日現在)	
1.採用している退職給付制度の概要	
<p>当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けており、平成元年11月に適格退職年金制度へ全面移行しております。</p>	
2.退職給付債務に関する事項(平成14年3月31日現在)	
退職給付債務	209,255 千円
年金資産	140,598 千円
未積立退職給付債務	68,657 千円
会計基準変更時 差異の未処理額	千円
退職給付引当金	68,657 千円
3.退職給付費用に関する事項	
(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)	
退職給付費用	67,979 千円
会計基準変更時 差異の費用処理額	千円
勤務費用(注)	67,979 千円
(注)当社は、小規模会社等に該当し簡便法を採用しているため、退職給付費用のうち会計基準変更時差異の費用処理額を除く額を「勤務費用」として記載しております。	
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項	
会計基準変更時差異の処理年数	一括償却

10. 税効果会計関係

当連結会計年度 (平成14年3月31日現在)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
(繰延税金資産)	
貸倒引当金損金算入限度超過額	36,347 千円
投資有価証券評価損否認額	31,572 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額	28,630 千円
賞与引当金損金算入限度超過額	27,341 千円
役員退職引当金損金算入否認額	26,867 千円
営業権償却否認額	14,504 千円
会員権評価損否認額	14,306 千円
その他有価証券評価差額金(差損)	9,083 千円
原材料評価損否認額	8,054 千円
その他	13,564 千円
評価性引当額	2,326 千円
繰延税金資産合計	<u>207,945 千円</u>
(繰延税金負債)	
特別償却準備金損金算入額	58,064 千円
未払事業税否認額	11,676 千円
その他有価証券評価差額金(差益)	8,799 千円
繰延税金負債合計	78,540 千円
繰延税金資産の純額	<u>129,405 千円</u>
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	41.7 %
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.1 %
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.3 %
住民税均等割等	2.7 %
事業税の減免額	1.5 %
繰越欠損金	1.0 %
適用税率の調整	0.7 %
その他	0.1 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>47.3 %</u>

11. 関連当事者との取引

該当事項はありません。

12. 1株当たり情報

当連結会計年度 (平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)	
1株当たり純資産額	850円18銭
1株当たり当期純利益	15円45銭

13. 後発事象

当社は、生産の効率化と市場のグローバル化に対応するため、中国浙江省杭州市に新工場を建設することを目的として、平成14年5月15日「杭州経済技術開発区浙江杭州輸出加工区」内に当社100%出資による「杭州泰谷諾石英有限公司」を設立いたしました。

現在新工場建設のための諸手続中ではありますが、平成14年末竣工及び生産開始を目標に計画を推進中であります。

商号	杭州泰谷諾石英有限公司
英文表示	HANGZHOU TECHNO QUARTZ INC.
所在地	杭州経済技術開発区浙江杭州輸出加工区内 M14-17-1
代表者名	代表取締役社長 森 憲 司
登録資本	440万米ドル(内設備投資額340万米ドル)
大株主	テクノクーツ株式会社100%
敷地面積	25亩(約5,000坪)
建物	3,500平方米(約1,000坪)
建設計画	平成14年6月起工、12月竣工予定
設立目的	主に米国向け半導体製造装置用石英製品・シリコン製品の加工製造を目的としており、販売はテクノクーツ株式会社が担当します。
登記日	平成14年5月15日
操業開始	平成14年12月を予定
従業員	80名
生産計画	初年度 260百万円 2年目 520百万円 3年目 1,040百万円